



先進封裝

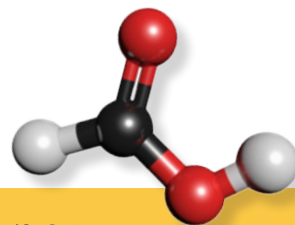
F系列真空甲酸爐

應用於半導體生產和先進封裝的焊接系統
具有甲酸的應用和高溫設定選項

使用可自製式載具和在線解決方案進行
高達 450°C 的高溫回流 / 真空焊接系統



焊接系統涵蓋多種設定應用



工藝氣體

- 甲酸* (CH_2O_2)
- 氫氣* (H_2 - 100 %)
- 氮氣 (N_2 - 始終需要)

*不能同時應用

溫度

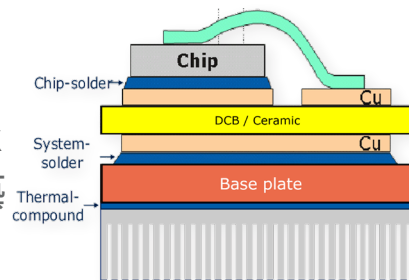
- 高達450 °C的高溫焊接 *
- SAC 305*
- 錫鎢合金*

工藝製程

- 真空
- 有Flux的焊片
- 無Flux的焊片*

應用舉例

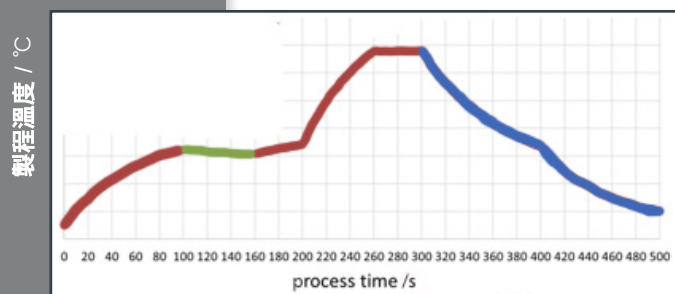
- IGBT • DCB • Die Attach • Opto Laser • Heatsink
- 普通銅面 • 蒸氣相置換 • 清洗工藝



SMT甲酸爐亮點

高溫真空在線回流焊接系統可提供:

- 全對流加熱
- 同一製程中滿足不同的產品
- 通用載具 — 靈活放置
- 智能安全設置
 - > 全封閉系統
 - > 氮氣(100 ppm的殘氧含量或更少)
 - > 智能氣體警報探測器
- 高效的蒸汽工藝(消耗更少的氮氣和甲酸)
- 三個加熱區, 三個冷卻區(可靈活配置)
- 加熱區可選擇三個真空腔
- CT時間 90 — 180秒(標準DCB條件下)
- 透過風扇速度控制熱傳遞



Dimension (l x w x h)	6,5 m x 2,0 m x 1,8 m
Process temperature	300 °C / 450 °C / 450 °C
Product size (l x w x h)	400 mm x 430 mm x 90 mm
Movement	left-right

no toolings needed
(for soldering)



回流焊接



真空焊接



溫度處理



定制解决方案



舊機翻新



先進封裝



Distributor:

SMT Thermal Discoveries
Roter Sand 5-7
97877 Wertheim - Germany
t: +49 (0)9342 970 0
www.smt-wertheim.com